

## 枚葉式半導体洗浄装置の世界シェア60%\*以上を達成

大日本スクリーン製造株式会社は、2008年の枚葉式スプレー洗浄装置<sup>※1</sup>市場で、60.3%\*のトップシェアを獲得しました。これにより当社は、半導体製造の洗浄工程の中で当社が手掛ける主要装置分野すべてにおいて、50%以上の世界シェアを獲得しました。

近年の半導体業界では、研究開発コンソーシアムや大手ロジック系メーカーなどを中心に、来るべき次世代半導体市場への展開を見据えた微細半導体チップの開発が急務となっています。そうした中、チップのさらなる微細化や配線の多層化にも対応できるダメージの少ない処理技術や、微小なごみおよび金属不純物などの汚染物質の除去技術が強く求められるようになり、半導体製造工程の約4分の1を占めるウエハー洗浄工程では、枚葉式スプレー洗浄装置の需要が急速に拡大しています。

こうした需要を背景に、深刻な景気後退にある半導体業界において、当社では米国や台湾への出荷が堅調に推移。2008年の枚葉式スプレー洗浄装置市場において、前年の40.6%\*から60.3%\*へと大幅にシェアを伸ばしました。また、バッチ式洗浄装置<sup>※2</sup>では57.4% (前年50.3%)\*、スピンスクラバー<sup>※3</sup>では80.1% (前年70.7%)\*という圧倒的な世界シェアを獲得し、洗浄工程の中で当社が手掛ける主要装置分野すべてにおいて過半数のシェアを獲得。当社の半導体洗浄装置の地位が、一層強固なものとなりました。

当社は今後も、世界トップシェアに裏付けられた高い製品競争力とサービス体制を一層強化し、顧客ニーズに応える多彩な洗浄装置を提供することにより、半導体業界の技術革新に貢献するとともに、顧客満足度の一層の向上を図っていきます。

※1 枚葉式スプレー洗浄装置

薬液をスプレーして、ウエハーを1枚ずつ洗浄する装置。処理量がバッチ式より少ない(当社装置では1時間当たり300枚)が、洗浄能力が高い。

※2 バッチ式洗浄装置

複数枚のウエハーを一度に薬液などに浸して洗浄する装置。処理能力が高く(当社装置では1時間当たり650枚)、大量生産に向く。

※3 スピンスクラバー

純水のみで洗浄できる工程などで使用される装置。ウエハーを軟らかいブラシと純水で物理洗浄する。

\* 出典：ガートナー「Semiconductor Equipment Market Share Database」Authors: Klaus Rinnen, Dean Freeman, Bob Johnson, Mark Stromberg, Ogawa Takashi and Masatsune Yamaji, 9 April 2009  
(Revenue from Shipments of Single Wafer Processors, Auto Wet Stations and Scrubbers, Worldwide)